

专用设备行业点评报告

半导体设备: SK海力士业绩超市场预期,看好国内长鑫HBM扩产利好先进封测设备商增持(维持)

2026年05月11日

证券分析师 周尔双

执业证书: S0600515110002
021-60199784

zhouersh@dwzq.com.cn

证券分析师 李文意

执业证书: S0600524080005
liwenyi@dwzq.com.cn

投资要点

- 受益AI需求带动,SK海力士业绩高增:** 2026年一季度公司营收52.58万亿韩元(约2441亿元人民币),同比+198%/环比+60%;净利润37.61万亿韩元(约1746亿元人民币),同比+406%/环比+96%;净利率约77%,创全球半导体历史新高,超过英伟达(65%)和台积电(58%)。背后核心驱动因素为AI算力需求爆发、带来HBM+DRAM价格暴涨(ASP环比+60%)、SK海力士占据主导地位、26Q1HBM市占率近60%、绑定英伟达HBM3/3E/4。
- 后摩尔时代下先进封测重要性提升,国内长鑫积极扩产HBM:** 后摩尔时代先进封测重要性日益提升,根据盛合晶微招股书,HBM价值量占比最高,其中英伟达B200中HBM成本为2720美元/颗、占比约42%、博通公司TPUv6中HBM成本为991美元/颗、占比约40%、美满Trainium2中HBM成本约1060美元/颗、占比约30%。国内对标长鑫存储已启动HBM的扩产,计划通过IPO募集295亿元,用于现有产线技术升级改造、DRAM(包括HBM)技术升级以及前瞻技术研发。
- HBM等先进封装技术快速发展,带来封测设备新需求:** (1)测试机: SoC芯片设计和制造的复杂性大幅增加,同时先进存储芯片为AI算力芯片提供高带宽的数据存储和传输支持、其容量和带宽的不断提升也进一步增加了芯片的复杂性,对高性能测试机需求显著增长;(2)封装设备: AI芯片主要采用HBM、CoWoS等2.5D、3D封装,涉及TSV刻蚀设备、薄膜沉积设备等前道图形化设备、同时对减薄机要求提升、还新增了混合键合等新电气互联方式。
- 投资建议:** (1)测试设备: 关注AI芯片带来的国产存储、SoC测试机突破,相关标的长川科技、华峰测控等;(2)封装设备: 国产AI芯片采用CoWoS和HBM先进封装,中国在封测环节具备较强全球竞争力,国内先进封装有望进入起量元年,关注国产封装设备新机遇,相关标的为北方华创(TSV刻蚀)、中微公司(TSV刻蚀)、拓荆科技(薄膜沉积+键合)、芯源微(涂胶显影+键合机)、华海清科(减薄机)、盛美上海(电镀机)、晶盛机电(减薄机)、迈为股份(磨划+键合)等。
- 风险提示:** 下游扩产速度不及预期,设备国产化进程不及预期。

行业走势



相关研究

《AI PCB 钻孔工艺专题: PCB 升级+孔径微小化, 钻孔设备&耗材需求量价齐升》

2025-12-16

《固态电池设备专题深度系列二: 干法成膜——高性能固态电池量产的关键》

2025-11-22

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>